



Velocity. Versatility. Value.

极小和超薄芯片编程技术的领导者

Data I/O 最新推出的自动化编程系统 PSV7000 拥有业界最专业及最先进的编程技术，能够轻松处理包括 SOT 封装在内的各种极小封装尺寸的芯片。PSV7000 利用其最先进的激光对准系统，运动控制及拾取芯片的技术为极小及超薄封装尺寸芯片的处理提供了完美的解决方案与最佳工作平台。

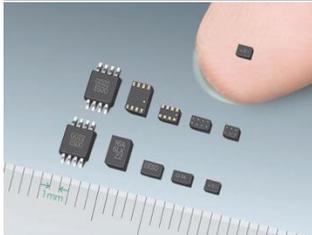
我们与激光技术的世界领先企业共同合作开发了编程业界第一个使用双吸嘴装置的空中对准系统。Data I/O 的自动化编程设备 PSV7000 能够处理如 0603 (1.5 毫米 x 0.8 毫米) 的芯片，同时设备搭载的激光系统也成功通过了 0.2 毫米 x 0.4 毫米小封装尺寸芯片的测试。

PSV7000 还是世界第一台运用 H-Bot 机械臂技术的自动化编程系统。设备采用的轻便简洁设计使得其搭载的 PnP 装置可以直接在滑轨上运行而取代了传统采用的 X-Y 轴上运行的方式，在提供了更好的精度与重复性的同时又减少了磨损发生的几率。

PSV7000 利用自身携带的 1 微米精度非接触式直线编码器实现了真正的闭环控制并使其拾取装置能够准确到达指定位置。设备还采用了 SMT 设备常使用的柔性吸嘴从而能更好的满足极小封装尺寸可编程 IC 的编程需要。

PSV7000 的前瞻性设计使其能轻松处理现今市面上各种极小封装尺寸的芯片，同时也能顺应未来芯片向更小更薄趋势发展的需要。如有更小封装尺寸芯片的问世，我们会同步提供相应的信息。

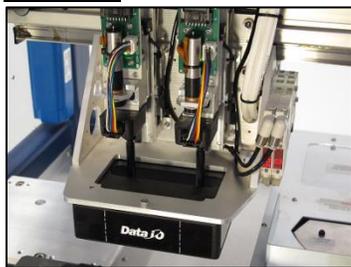
极小封装尺寸的可编程 IC



Data I/O 的最新 PSV7000 自动化编程系统能够处理市面上的极小封装尺寸芯片(1.5 毫米 x 1.5 毫米)

系统支持最新各种小尺寸封装芯片如 SOT、SON、MLF 及 TDFN。

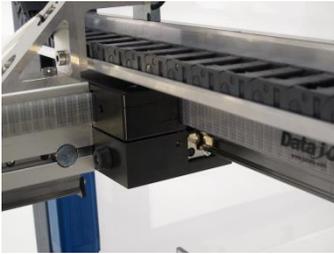
空中对准



搭载高性能激光对准系统的双空中对准系统

性能	PSV7000	其他系统	
	空中对准	向上摄像头	芯片定位器
双对准系统	有	无	无
头部感应	有	无	无
对产能的影响	提高产能	无帮助	无帮助
引起引脚伤害的可能性	无	无	可能发生引脚损伤
*旋转分辨率	0.07°	可变	无

PSV7000 H-Bot 机械臂



高性能的 H-Bot 伺服驱动搭配双重编码器与 kinematic 算法确保设备实现最高的精确度与产出

性能	H-Bot 机械臂	X-Y 驱动
是否是减少负载和运动惯量的运动电机	是	否
简化设计: 单皮带驱动系统	是	否
高定位重复性	±0.030 毫米	可变的
体积小	是	否
固定电机使得线缆连接更为简单	是	否
单不锈钢加固皮带	是	否

X-Y 线性编码器



使用线性编码器能够达到最高定位精确度并实现可重复性的功能

区别于一般设备使用安装在电机轴上的旋转编码器来推断当前位置，PSV7000 利用自身携带的 1 微米精度非接触式直线编码器实现了真正的闭环控制，使其拾取装能够置准确到达指定位置。在这个基础上，运动系统也具备超高的分辨率及良好的重复性等优势，因此能够更好的取放小芯片。

PSV7000 采用高质量 吸嘴



PSV7000 采用 SMT 贴片机上通常使用的柔性吸嘴装置

设备采用高质量的 PnP 吸嘴能够处理封装尺寸在 1.5 x 1.5 毫米至 32 x 32 毫米范围内的不同规格芯片。同时，我们提供了三种不同尺寸的吸嘴来满足您不同的编程生产需求。(外围直径/ 内部直径)

- 1.5/1.0 毫米 (小号)
- 5.0/3.2 毫米 (中号)
- 9.5/8.0 毫米 (大号)

PSV7000 超刚性结构



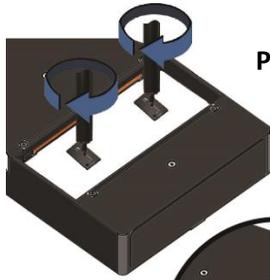
PSV7000 的设备框架稳固性极佳

PSV7000 的框架是基于稳定、坚固的设计理念而建造。这样的设计使得设备具有超强抗震性的优点同时还满足了在高速运转环境下，系统仍能充分满足处理小封装尺寸芯片时所需达到的拾取精度与可重复性等要求。



Velocity. Versatility. Value.

PSV7000 能够同时完成 2 颗芯片的校正工作。该系统可以通过激光对准系统同时能够吸取两个芯片并在激光的照射下旋转 360 度得到芯片的各边轮廓。这样，PSV7000 的激光对准系统可以一步实现芯片的中心位置和旋转角度的纠正。紧凑的光学设计使设备对于各种封装尺寸芯片的吸取都达到了高可靠性与稳定性的目标，当然其中也包括小至 1.5 毫米 x1.5 毫米的芯片。



PSV7000的激光对准系统可以一步完成芯片的中心位置定位和旋转角度纠正的工作

